

证券代码：300672

证券简称：国科微

公告编号：2025-028

湖南国科微电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国科微	股票代码	300672
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄然	叶展	
办公地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号	长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段 9 号	
传真	0731-88596393	0731-88596393	
电话	0731-88218880	0731-88218891	
电子信箱	ir@goke.com	ir@goke.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是工业和信息化部认定的集成电路设计企业，成立以来一直坚持自主研发的开发理念，公司长期致力于超高清智能显示、智慧视觉、人工智能、车载电子、物联网、固态存储等领域大规模芯片及解决方案的开发。自设立以来，公司一直专注于芯片设计及解决方案的开发、销售以及服务，主营业务未发生变化。公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发在音视频编解码、影像和声音信号处理、SoC 芯片、直播卫星信道解调、北斗导航定位、数模混合、高级安全加密、固

态存储控制器芯片、多晶圆封装以及嵌入式软件开发等关键技术领域积累了大量的自主知识产权的专利、版图、软件著作权等核心技术。

公司的主营产品包括直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、8K解码芯片、泛屏商显芯片、智慧视觉芯片、端侧人工智能芯片、无线局域网芯片、车载SerDes芯片、卫星导航定位芯片、固态存储控制器芯片及相关产品等一系列拥有核心自主知识产权的芯片等。公司产品主要应用于卫星智能机顶盒、有线智能机顶盒、IPTV、OTT机顶盒、TV/商显、网络摄像机、后端NVR/DVR视觉处理产品、固态硬盘产品相关拓展领域以及车载定位与导航、无人机等对导航/定位有需求的领域。基于公司在无线连接领域的技术积累，公司物联网业务已拓展至无线局域网网卡芯片领域。同时，公司正积极拓展AI PC、机器人等端侧人工智能领域、车载数据传输等领域。

(二) 报告期内公司主要集成电路产品所属细分领域的主流技术水平及市场需求变化情况及对公司影响，所在行业的竞争情况和公司综合优劣势及下一报告期内下游应用领域的宏观需求

1、超高清智能显示领域：

视频是信息呈现、传播和利用的重要载体，是电子信息产业的核心基础技术之一。目前视频技术正在从高清向超高清（4K/8K）普及，同时向XR及智能化场景演进。超高清视频以其更强的信息承载能力和应用价值，将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

2019年工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》（简称“行动计划”），明确将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

2021年2月1日，中央广播电视总台8K超高清电视频道试验开播，全球首次实现8K超高清电视直播和5G网络下的8K电视播出。

2022年1月，工业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总台等六部门联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，“百城千屏”活动以试点示范工程为引领，通过新建或引导改造国内大屏为4K/8K超高清大屏，丰富超高清视音频服务场景，加速推动超高清视音频在多方面的融合创新发展，催生新技术、新业态、新模式。2022年2月4日，北京冬奥会开幕，中央广播电视总台首次用8K技术实现了冬奥会赛事的直播，给全世界呈现了一场完美的体育盛会。2022年9月，在北京、上海、重庆、广东、福建、浙江、四川、山东、吉林、辽宁等22个省市70多个城市的270余块户外地标大屏，同步直播了总台8K中秋晚会信号，为各地观众送上美轮美奂的超高清观赏体验。

在2023年杭州亚运会和成都世界大学生运动会中，8K直播将精彩的比赛更加细腻生动地展现在观众眼前。公司全系列芯片都支持HDR VIVID，Audio VIVID等国产标准，为国产技术的落地应用起到了积极的推动作用。

近年来随着“全国一网”“宽带中国”等政策快速推进，各地有线运营商和三大电信运营商都在大规模部署智能4K超高清机顶盒。有线电视全国一网整合基本完成，4K终端稳步发展，有线电视行业将会迎来全新发展机会，公司的4K芯片已经导入除西藏自治区以外的各省、市、自治区，并已经按规模稳定出货。2022年6月21日，国家广播电视总局公布《关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》，意见指出，自2022年7月1日起，直播卫星新增传输的电视频道应主要为高清超高清频道，新增机顶盒应为高清、超高清智能机顶盒，同时，有序推进直播卫星高清超高清机顶盒对标清机顶盒的替代；到2025年底，基本关停标清节目，这标志着从2025年开始，直播卫星将迎来一波换机潮，由标清过渡到高清和超高清。

2021年，公司针对IPTV运营商市场推出了4K解码芯片，于2022年在IPTV市场全面应用，在各运营商招标中取得了较好的市场份额，并开始在各省公司快速落地。2023年1月，中国移动启动IPTV机顶盒集采招标，采用公司IPTV芯片的厂商中标份额超过34%，公司取得了较大的释放份额，目前在大部分省份已经落地，正在大规模稳定出货中。另外，在中国联通2023年的集采中，公司所占份额超过50%，公司已于2024年基本完成中标份额的供货。在此过程中，公司积累了大量的各省软硬件适配和运营商招标落地工作经验，为深耕运营商市场打下了坚实基础。公司直播星4K智能机顶盒芯片及方案已在零售和个别省份的招标市场有一定出货，为2025年的大规模出货打下了坚实基础。

2024年，公司旗下共有5款产品通过鸿蒙4.0生态产品兼容性认证，全面拥抱国产生态；鸿蒙5.0项目已经在商显产品芯片中立项启动开发，预计2025年上半年产品开始导入。鸿蒙生态将是公司未来发力的重点方向之一。

2024年4月，第83届中国教育装备展示会在重庆召开，多款搭载公司4K/8K超高清显示芯片的教育类电子白板等产品亮相展会，为用户带来卓越的显示交互体验。

公司已通过自主研发积累了大规模SoC芯片设计技术、视频编解码技术、NPU技术、PQ技术、高级安全加密技术、低功耗设计技术、多晶圆封装技术以及嵌入式软件开发技术等关键技术。目前，公司超高清智能显示类产品涵盖卫星、有线、

地面、IPTV/OTT及TV和泛屏商显等领域，产品线丰富，种类齐全。同时，公司正在基于现有音视频芯片，规划和开发AI芯片，AI芯片覆盖传统音视频行业的新一轮AI产业升级需求。

2、智慧视觉领域：

公司智慧视觉系列芯片产品主要应用于安防行业中的视频监控领域。视频监控主要包括前端摄像机设备及后端录像机设备。前端设备主要为模拟摄像机和网络摄像机，核心部件分别包括一颗ISP芯片和IPC SoC芯片；后端设备主要为NVR/DVR，分别内置一颗NVR SoC芯片和DVR SoC芯片。

随着全球传统安防正在向智能（AI+）安防转变，IPC SoC芯片的出货量也在逐步增加。数据显示，2024年全球IPC SoC芯片的出货量超过了30,000.00万颗，其中，中国IPC SoC芯片的出货量达到了14,000.00万颗，海外市场增长迅速。根据赛迪顾问预测，预计到2026年全球IPC SoC芯片的市场规模将达到10.06亿美元，中国IPC SoC芯片的市场规模将达到8.15亿美元。

在安防监控领域，随着高清化、智能化的长期演进，人工智能在行业内得到更多的应用。近年来，人工智能产业正以其高端的新兴技术、巨大的商业价值、广阔的应用前景和庞大的产业空间迅速发展，成为新的重要经济增长点。习近平总书记曾指出：“人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题”。随着我国城镇化进程的进一步发展，智慧城市建设将进一步推动智能安防领域芯片的市场需求。

为满足市场需求，公司在ISP、编解码、NPU、低功耗等核心技术持续投入，进一步提升不同细分市场的产品竞争力。报告期内，为进一步满足市场智能化升级趋势，公司积极进行产品布局，完成了从传统/行业安防（带算力和不带算力）及消费类IPC从高端到低端的完整全系列自研产品规划，产品更加丰富，客户覆盖范围更大。公司在原有普惠型智能5MP/4MP/3MP芯片大规模出货的基础上，持续迭代，研发了新一代带AI算力（全新ISP升级，集成了前沿AI-ISP技术、多目技术）具备性价比的全自研4K 7606V1产品，产品已于2024年第四季度推出，刚出道即在头部安防客户测试获得高度评价，CPU性能、传统ISP效果、AI-ISP效果达到了行业顶尖水平。公司同时立项了经济款AI-ISP和安防腰部产品，预计在2025年度第二季度推出极具性价比的产品。为适应消费类IPC市场的变化，公司规划了多目+AOV极具性价比的常电和低功耗系列7203V1芯片，对应产品预计在2025年第二季度推出。另外，为了扩大市场份额，公司在中低端消费类产品市场已有对应的项目立项，预计在2025年推出。作为SVAC联盟成员，公司积极跟进SVAC产业化趋势，将根据新国产编解码发展趋势，在合适时间点进行相关芯片的开发。

在鸿蒙生态领域，公司的智慧视觉系列产品均有配套鸿蒙解决方案，并已在客户端实现量产出货。

3、车载电子领域：

中国汽车工业协会发布数据显示，2024年，我国汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，产销量再创新高，继续保持在3000万辆以上规模，连续16年稳居全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量达到汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点。汽车智能化迅速的发展，促进了传感器和显示屏安装数量的增多，数据传输和智能处理需求持续增强。

（1）车载AI芯片市场目前主要分为两大类，一类为大算力芯片，主要应用场景为域系统控制器（座舱域，智驾域，舱驾一体等）；一类为小算力芯片，主要应用场景为相对单一的车载产品，如前向ADAS模组、智能行车记录仪、流媒体电子后视镜、电子外后视镜、360全景泊车、驾驶员和座舱监测系统等。

在大算力芯片市场，当前主要供应商为美国英伟达和美国高通，上述两家企业在大算力芯片市场领域占据领先，另外，国内地平线等企业也陆续有量产项目。小算力芯片算力大多在8TOPS及以下，目前，小算力芯片市场主要供应商有TI、安霸、地平线等。

（2）车载SerDes芯片具备大数据量、高速、低延迟、无损、远距离传输等特点，可广泛应用于传感器数据传输、显示屏数据传输，在智能座舱、智能驾驶等产品中发挥重要作用。随着汽车智能化发展，车载SerDes芯片发展潜力巨大。

目前美国两家企业（Maxim和TI）占据主要市场份额，近几年来也有部分初创企业开始进入这一领域，如上海慷智、天津瑞发科、南京仁芯科技等。车载业务场景对SerDes芯片要求极高，性能、功耗、EMC、ESD、可靠性、自适应性等维度都需要满足产品应用的需求。

公司主研芯片产品包括小算力车载AI芯片和高速SerDes芯片，目前形成了系列化芯片产品布局，通过扩展SerDes芯片的传输速率、数据通路数、接口种类，以及扩展车载AI芯片的算力、算法、接口种类，两类芯片可以形成360环视、CMS/OMS/DMS/DVR、智能驾驶、智能座舱等产品的完整解决方案。

4、人工智能领域：

2024年3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。这标志着人工智能将成为未来经济的重要发展引擎。人工智能的发展离不开算力基础设施的支撑。

2025年政府工作报告中明确提出，激发数字经济创新活力，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局，打造具有国际竞争力的数字产业集群。加快完善数据基础制度，深化数据资源开发利用，促进和规范数据跨境流动。促进平台经济规范健康发展，更好发挥其在促创新、扩消费、稳就业等方面的积极作用。2025年两会更明确指出了人工智能的发展方向，其中明确提出“大模型+智能终端”的发展方向，同时随着以DeepSeek为代表的通用大模型技术及MoE、模型蒸馏等代表性大模型技术的发展和成熟，标志着AI大模型智能终端产业将迎来快速发展和应用。

近年来，人工智能大模型带来的技术创新和变革突破了传统人工智能小模型的技术瓶颈和应用边界，推动了人工智能应用的蓬勃发展。

2023年，公司提出“ALL IN AI”战略，聚焦人工智能边缘计算AI SoC研发，基于大模型+SoC赋能智能终端大模型应用。2024年，公司围绕“ALL IN AI”战略，聚焦人工智能边缘计算智能终端应用，解决传统NPU芯片大模型推理效率不足问题，公司创新提出MLPU芯片概念（面向多模态大模型的新型AI芯片架构），既能高效支持大模型推理计算，同时兼容传统小模型的高效推理。基于MLPU创新架构设计，公司形成了从16TOPS至100TOPS的智能终端AI SoC系列产品规划，形成了低中高AI SoC布局并已投入研发，主要应用于机器人（含具身智能）、AI PC、无人机、工业计算等边缘计算智能终端，预计2026年开始逐步量产上市。MLPU创新架构具有高效、低功耗、高性价比的特点，相比于市面已有的NPU芯片，能够更高效的支持大模型的端侧部署和推理应用，从而保证模型推理效率和应用效果；为智能终端大模型应用带来变革性的创新AI芯片平台，激发智能终端创新。

同时，基于MLPU的创新架构设计，公司积极布局AI生态建设。公司围绕大模型及其大模型产品，深度优化适配，提供从模型压缩转化、推理部署、应用开发端到端全栈大模型工具链，方便开发者和客户能够简单高效的完成模型部署和应用开发，打造更具通用性、可用性和应用性的AI SoC系列产品。

5、物联网领域：

无线局域网是一种使用无线通信技术连接计算机网络的方式，目前已经广泛应用于日常生活中，是一种设备间传递数据的便捷通信方式。目前，无线局域网技术正在向着高速高带宽低延时的技术方向演进，最新的无线局域网技术的通信带宽高达320MHz，最高速率可以达到30Gbps，AP单设备的延时可以稳定在3ms以内。无线局域网技术的发展催生出新应用，这将为消费升级、行业创新、社会治理提供新场景、新要素、新工具，可有力推动经济社会各领域的深刻变革，成为国民经济的新增长点和强劲推动引擎。

近年来，无线局域网在认证、安全和网络性能等方面取得了显著的进步，技术的进步带来应用的蓬勃发展和产业的繁荣，具体的驱动力主要有以下几点：1、互联互通技术的快速发展从根本上改变Wi-Fi产业的生态系统，推动运营商、公共场所服务商、互联网企业间建立Wi-Fi漫游关系，形成Wi-Fi漫游联盟；2、网络性能及容量显著提升，应用范围显著扩展，对于网络运营商来说，其对Wi-Fi网络的技术需要包括出色的传输速度、网络容量和网络密度，以满足数据流量迅猛上升的客观需求；3、移动互联网和物联网技术的迅猛发展驱动数据流量的中心从有线到无线的加速转移。

除了技术方面的推动外，在业务层面，增强现实、新一代游戏的应用以及大屏终端、超高清显示器、四屏融合等新型终端体验的鹊起也推动了Wi-Fi应用的普及；在政策方面，十三五期间提出了构建先进泛在的无线宽带网，深入普及高速无线宽带，实现乡镇及人口密集的行政村全面深度覆盖，在城镇热点公共区域推广免费高速无线局域网接入，政策的加持也促进了无线局域网的普及。在技术、业务和政策的三重推动下，Wi-Fi广泛应用于路由/网关、手机/平板、TV/OTT/IPTV、AR/VR、车载、笔电、IPC、图传、家电等领域。根据半导体行业调查机构TSR于2022年6月发布的

《2022 wireless Connectivity Market Analysis》，2024年，Wi-Fi的市场容量预计突破50亿只，并保持每年5%的复合增长率，在数量增加的同时，Wi-Fi市场还呈现应用的多元化增长，这对于Wi-Fi领域的后入者来说是一个很有利的因素，后入者可以根据新的产品需求研发出更适合市场需求的产品。

目前从全球来看，无线局域网网卡芯片的供应商主要集中在美国、中国台湾和中国大陆，其中美国的高通、博通及中国大陆的海思是高端芯片的代表；中国台湾的MTK和瑞昱在高端芯片占有一定的份额，在中低端芯片领域占有主导地位；国内的爱科微、希微、高拓、南方硅谷在中低端芯片领域占有一席之地。

公司确定了立足中低端、积极发展中高端，并在中高低端实现无线局域网芯片的全面国产替代的策略。公司针对TV、IPTV以及OTT、AR/VR、车载市场、PC开发了Wi-Fi6 2T2R无线网卡芯片，目前该芯片开发完成并完成调试，正在导入国内主流的电视和运营商的方案厂商及网卡厂商；在Wi-Fi6 2T2R的基础上，公司的Wi-Fi6 1T1R+蓝牙的Combo芯片开发即将完成，准备投产；同时，针对IPC、行车记录仪、图传、网卡市场开发的Wi-Fi4 1T1R无线局域网芯片已经量产。公司通过自主研发积累了2.4GHz/5GHz频段的宽带射频技术、射频的校准技术、低功耗技术、高性能无线通信算法、嵌入式开发以及多操作系统驱动开发技术等多项核心技术。目前，公司在着力推进无线局域网技术的研发布局，未来将形成高中低芯片产品家族，同时推出Wi-Fi与蓝牙、星闪等短距离无线通信技术融合的芯片产品及方案。另外，公司正积极探索卫星通信芯片等新业务领域。

6、固态存储领域：

随着5G、AI、物联网、智能驾驶汽车等新兴技术的蓬勃发展，将加速走入数据产生和存储需求的爆发性增长阶段。固态硬盘存储全球范围内继续保持高速增长，尤其中国的固态硬盘存储行业增速更快。得益于国内信息化的快速发展与“东数西算”国家级工程的启动，在超大规模数据中心用户的推动下，相关技术将推动性能存储的未来发展。从消费级存储到企业级存储，中国固态硬盘行业将保持较高的增长率。2023年8月，财政部官网发布通知，针对国产计算机和操作系统的采购向社会公开征求意见，采购需求标准包括了便携式计算机、一体式计算机、通用服务器、台式计算机等，这是政府层面首次高层次地公开发布采购需求标准，此举意味着国产化将走向深化。

随着《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国数据安全法》等一系列法律法规的出台，在高安全领域，数据安全已然成为必须受到重视的问题之一。十四五规划的落地文件，也明确了加强密码类产品在国产化领域的应用。随着“放管服”改革进一步深化，商用密码技术推陈出新，我国商用密码产业蓬勃发展。

（三）公司所处行业竞争格局情况

1、超高清智能显示领域

公司超高清智能显示芯片主要应用在直播卫星机顶盒、有线机顶盒、IPTV/OTT机顶盒及TV/商显领域。在这些领域，主要的芯片方案供应商有国科微、晶晨股份、MTK、瑞芯微、全志科技等厂商。在有线机顶盒领域，公司目前已在全国超过90%的省份实现量产并持续出货。在IPTV/OTT领域，公司已完全进入国内四大运营商市场，并基本完成供货，目前正积极与运营商对接，探讨运营商AI产品的应用落地场景及芯片需求。在教育机、广告机等领域，由于鸿蒙生态的加持，公司处于上升势头，2024年实现稳定出货，2025年有望带来新一轮的增长。

2、智慧视觉领域

公司智慧视觉系列芯片主要应用在智能安防领域，在该领域内，主要的芯片方案供应商有国科微、富瀚微、北京君正、星辰科技、联咏科技、瑞芯微、华为海思等厂商；公司在ISP图像处理、编解码、视频与图像分析等关键技术方面持续投入，为市场提供有竞争力的产品，可广泛应用于平安城市、智能交通、平安乡村、楼宇、社区等场景。

3、车载电子领域

公司推出的车载AI系列芯片主要应用在前装智能摄像头、行车记录仪、流媒体电子后视镜、电子外后视镜、摄像头监控系统、驾驶员疲劳监测系统、座舱监控系统、前视ADAS一体机等产品上。在上述产品领域中，主要芯片供应商有安霸、豪威、地平线等。

同时，公司推出的串行解串（SerDes）芯片在前装车载业务领域，主要应用于智能座舱和智能驾驶的摄像头端和显示屏端的数据传输。在这些产品领域中，主要芯片供应商有Maxim、TI、瑞发科等。公司系列化产品已经导入相关市场。

4、人工智能领域

公司人工智能AI SoC系列产品主要围绕大模型应用于机器人（含具身智能）、AI PC、无人机、工业计算等大模型智能终端领域。在这些领域，主要的芯片方案供应商有国科微、算能、芯动力、爱芯元智等厂商。在大模型+智能终端领域，公司MLPU架构是专门为大模型设计的创新AI架构，无论在大模型推理效率、功耗和成本上，都领先于传统NPU芯片，产品具有极强竞争力。同时基于MLPU创新架构已形成系列化低中高模型AI SoC布局，产品研发节奏和规划市场领先。

5、物联网领域

公司研发的无线局域网芯片将主要应用在IPC、TV、IPTV/OTT机顶盒、行车记录仪、图传、PC等领域。在这些领域，主要的供应商有瑞昱、MTK、爱科微、希微、高拓、南方硅谷等厂商。在IPC、行车记录仪、图传领域，主要的供应商有瑞昱、南方硅谷、高拓，其中瑞昱占有50%以上的市场份额。在TV/IPTV领域，主要供应商有瑞昱和MTK。公司相关产品开发完成后，将积极导入相关市场。

6、固态存储领域

目前，全球存储芯片市场主要被韩国、欧美以及台湾地区企业占据，头部集中度高。海外厂商凭借先发优势以及在终端市场的品牌优势，占据了大部分市场份额。中国大陆半导体存储产业起步较晚，出现在各个存储领域与知名公司直接竞争并突破海外技术垄断的公司已在技术上逐步缩小与海外大厂的差距。

公司拥有核心的产品研发、设计、生产和销售能力，在固态存储行业中的知名度、影响力以及上下游供应链都处于优势地位。从成立之初就扛起国产化大旗，从上游供应商、到自身内部技术体系、再到客户产品适配等方面，都深耕国产化技术体系。经过多年的积累，形成了领先行业的国产化存储技术与完整的国产化存储技术体系。针对公司主攻的国产替代市场、国内大客户群等特点，国产化存储技术成为公司技术体系的亮点，成为国产替代市场的技术标杆。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

元

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	7,667,633,581.22	7,340,270,887.08	4.46%	8,493,571,135.74
归属于上市公司股东的净资产	4,098,571,202.09	4,120,312,791.48	-0.53%	4,021,247,304.67
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	1,977,891,796.40	4,231,262,884.84	-53.26%	3,604,899,374.87
归属于上市公司股东的净利润	97,154,701.52	96,071,857.13	1.13%	151,878,848.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,547,239.49	40,980,155.12	-71.82%	125,337,134.19
经营活动产生的现金流量净额	-47,698,070.65	889,709,042.63	-105.36%	545,726,219.33
基本每股收益（元/股）	0.4488	0.4422	1.49%	0.8288
稀释每股收益（元/股）	0.4488	0.4422	1.49%	0.8288
加权平均净资产收益率	2.36%	2.36%	0.00%	5.48%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	342,571,085.55	508,248,078.02	351,255,629.96	775,817,002.87
归属于上市公司股东的净利润	41,204,164.04	-14,366,851.93	43,184,125.72	27,133,263.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,034,664.16	-23,125,352.35	37,062,104.88	-33,424,177.20
经营活动产生的现金流量净额	-102,163,877.63	-218,712,279.47	133,151,920.39	140,026,166.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,878	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
湖南国科控股有限公司	境内非国有法人	17.98%	39,035,306.00	0.00	质押	12,149,400.00			
长沙芯途投资管理有限公司	境内非国有法人	8.98%	19,491,864.00	0.00	不适用	0.00			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	6.54%	14,200,354.00	0.00	不适用	0.00			
向平	境内自然人	3.81%	8,268,952.00	6,201,714.00	不适用	0.00			
王春江	境内自然人	1.84%	3,993,300.00	0.00	不适用	0.00			
深圳前海千惠资产管理有限公司一千惠矿世红利 17 号私募证券投资基金	其他	1.10%	2,392,200.00	0.00	不适用	0.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07%	2,321,479.00	0.00	不适用	0.00			
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	1,698,765.00	0.00	不适用	0.00			
深圳前海千惠资产管理有限公司一千惠矿世红利 7 号私募证券投资基金	其他	0.75%	1,634,569.00	0.00	不适用	0.00			
深圳前海千惠资产管理有限公司一千惠矿世红利 87 号私募证券投资基金	其他	0.59%	1,282,400.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南国科控股有限公司为公司实际控制人向平先生 100% 持股公司，长沙芯途投资管理有限公司为公司实际控制人向平先生的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。								

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

 适用 不适用

单位：股

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
国泰君安证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产	2,418,735	1.11%	160,300	0.07%	1,698,765	0.78%	0	0.00%

品与设备 交易型开 放式指数 证券投资 基金								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

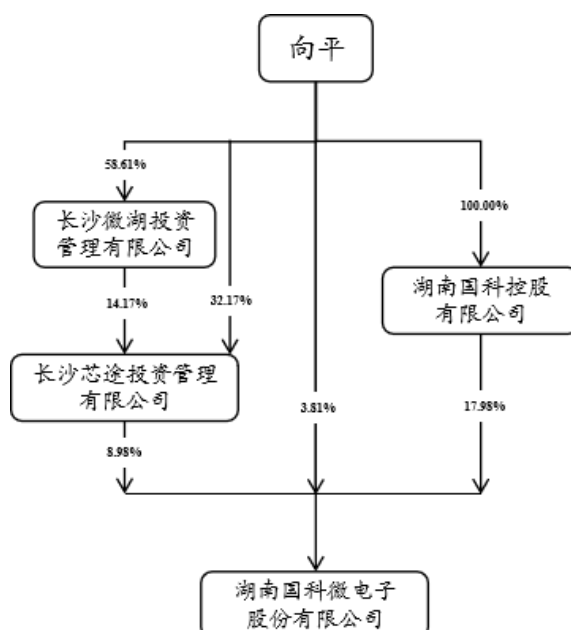
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

股份回购事项

2024年2月4日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格上限为93元/股（含）。

截至2025年2月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,134,182股，占公司该时点总股本的0.5223%，最高成交价为58.57元/股，最低成交价为42.09元/股，成交总金额为人民币56,719,528.06元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满，公司回购金额已达回购方案中回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限，本次股份回购方案实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。